

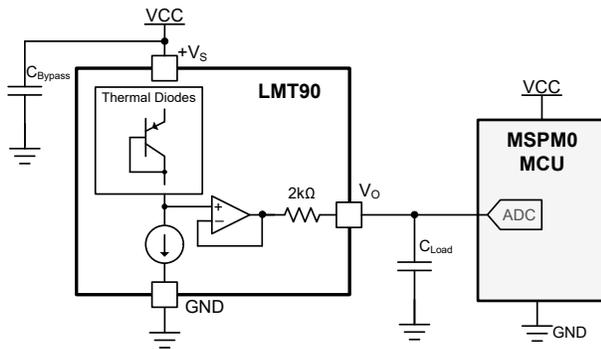
# LMT90 采用 SOT-23 封装的业界通用 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 精确模拟摄氏 ( $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ ) 温度传感器

## 1 特性

- 行业标准级传感器增益/偏移：
  - $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ ， $0^{\circ}\text{C}$  下  $500\text{mV}$
  - 插入功能等效于 **LM50C**
- LMT90 温度精度：
  - $25^{\circ}\text{C}$  时： $\pm 3^{\circ}\text{C}$  (最大值)
  - $-40^{\circ}\text{C}$  至  $+125^{\circ}\text{C}$  时： $\pm 4^{\circ}\text{C}$  (最大值)
- 工作电源电压范围： $4.5\text{V}$  至  $10\text{V}$
- 静态电流 (典型值)： $95\ \mu\text{A}$
- 采用标准 SOT23-3 封装
- 非线性度： $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$  (最大)
- 输出直流阻抗： $2\text{k}\Omega / 4\text{k}\Omega$  (典型值/最大)
  - 能够驱动大电容负载的
- 具有成本效益的热敏电阻替代产品

## 2 应用

- 手机、PC 和笔记本电脑
- 数据存储
- 电池管理
- 家用和多功能打印机
- 医疗和保健仪器
- HVAC 系统
- 电源模块



简化版原理图

## 3 说明

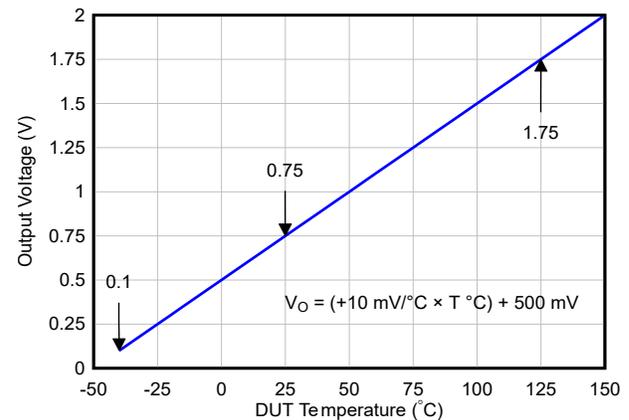
LMT90 器件是一款成本优化型精密模拟温度传感器，用作分立式热敏电阻的线性替代产品。该器件可以使用单个正电源测量从  $-40^{\circ}\text{C}$  到  $125^{\circ}\text{C}$  的温度。该器件的输出电压与温度成线性比例 ( $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ )，并在  $0^{\circ}\text{C}$  时具有  $500\text{mV}$  的直流失调电压。此失调电压允许在无需负电源的情况下读取负温度值。LMT90 的输出电压范围介于  $100\text{mV}$  ( $-40^{\circ}\text{C}$  时) 至  $1.75\text{V}$  ( $125^{\circ}\text{C}$  时)，简化了模数转换器 (ADC) 接口连接。

LMT90 是与 LM50C 等效的插入式，无需任何外部校准、修整或软件线性化，从而简化电源环境中的电路要求。由于 LMT90 的低电平静态电流 (通常约  $95\ \mu\text{A}$ )，自发热被限制为非常低的  $0.2^{\circ}\text{C}$  (在静止空气中)。此器件适用于 HVAC、电器和消费类电子产品应用。晶圆级的 LMT90 修整和校准支持长期可用性、低成本和一致的精度 ( $25^{\circ}\text{C}$  时为  $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ， $\pm 4^{\circ}\text{C}$  温度范围内)。

### 封装信息

器件型号	封装 <sup>(1)</sup>	封装尺寸 <sup>(2)</sup>
LMT90	DBZ (SOT-23, 3)	2.37mm × 2.92mm

- 有关更多信息，请参阅节 11。
- 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



全量程摄氏温度传感器 ( $-40^{\circ}\text{C}$  至  $125^{\circ}\text{C}$ )



## 内容

<b>1 特性</b> .....	<b>1</b>	<b>7.4 器件功能模式</b> .....	<b>11</b>
<b>2 应用</b> .....	<b>1</b>	<b>8 应用和实施</b> .....	<b>12</b>
<b>3 说明</b> .....	<b>1</b>	8.1 应用信息.....	12
<b>4 器件比较</b> .....	<b>3</b>	8.2 典型应用.....	12
<b>5 引脚配置和功能</b> .....	<b>4</b>	8.3 系统示例.....	14
<b>6 规格</b> .....	<b>5</b>	8.4 电源相关建议.....	14
6.1 绝对最大额定值.....	5	8.5 布局.....	14
6.2 ESD 等级.....	5	<b>9 器件和文档支持</b> .....	<b>17</b>
6.3 建议运行条件.....	5	相关文档.....	17
6.4 热性能信息.....	5	9.1 接收文档更新通知.....	17
6.5 电气特性.....	6	9.2 支持资源.....	17
6.6 典型特性.....	7	9.3 商标.....	17
<b>7 详细说明</b> .....	<b>11</b>	9.4 静电放电警告.....	17
7.1 概述.....	11	9.5 术语表.....	17
7.2 功能方框图.....	11	<b>10 修订历史记录</b> .....	<b>17</b>
7.3 特性说明.....	11	<b>11 机械、封装和可订购信息</b> .....	<b>18</b>

## 4 器件比较

**表 4-1. 器件比较**

特性	LMT90 <sup>(1)</sup> LM50C <sup>(1)</sup>	LM50B <sup>(1)</sup>	TMP235	LM60 <sup>(1)</sup>	LM61B <sup>(1)</sup>	LM20B	LM35 <sup>(1)</sup>
传感器增益 (mV/°C)	10	10	10	6.25	10	-11.77	10
传感器增益类型	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定
失调电压 (0°C 时) (mV)	500	500	500	424	600	1864	0
温度范围 (°C)	-40 至 125	-40 至 125	-40 至 150	-40 至 125	-25 至 85	-55 至 130	-55 至 150
<b>电源规格</b>							
V <sub>DD</sub> (V)	4.5 至 10	4.5 至 10	2.3 至 5.5	2.7 至 10	2.7 至 10	2.4 至 5.5	4 至 30
I <sub>Q</sub> (典型值) (μA)	95	95	9	82	82	4.5	67
<b>温度精度</b>							
25°C (典型值)	-	-	±0.5	-	-	-	±0.2
-55°C (最大值)	-	-	-	-	-	±2.5	±1
-40°C (最大值)	±4	-3.5/3	±2	±3	-	±2.3	±0.9
-30°C (最大值)	±3.85	-3.3/2.85	±2	±2.85	-	±2.2	±0.85
-25°C (最大值)	±3.8	-3.2/2.8	±2	±2.8	±3	±2.1	±0.8
0°C (最大值)	±3.4	-2.6/2.4	±1	±2.4	±2.5	±1.9	±0.65
25°C (最大值)	±3	±2	±1	±2	±2	±1.5	±0.5
30°C (最大值)	±3.05	±2.05	±1	±2.05	±2.1	±1.5	±0.5
70°C (最大值)	±3.45	±2.45	±1	±2.45	±2.75	±1.9	±0.7
80°C (最大值)	±3.55	±2.55	±2	±2.55	±2.9	±2	±0.7
85°C (最大值)	±3.6	±2.6	±2	±2.6	±3	±2.1	±0.75
100°C (最大值)	±3.75	±2.75	±2	±2.75	-	±2.2	±0.8
125°C (最大值)	±4	±3	±2	±3	-	±2.5	±0.9
130°C (最大值)	-	-	±2	-	-	±2.5	±0.9
150°C (最大值)	-	-	±2	-	-	-	±1
<b>封装尺寸</b>							
尺寸 [mm × mm × mm]	<b>SOT23</b> (3 引脚) 2.9 × 2.4 × 1.1	<b>SOT23</b> (3 引脚) 2.9 × 2.4 × 1.1	<b>SOT23</b> (3 引脚) 2.9 × 2.4 × 1.1 <b>SC70</b> (5 引脚) 2.0 × 2.1 × 1.1	<b>SOT23</b> (3 引脚) 2.9 × 2.4 × 1.1 <b>TO92</b> (3 引脚) 7.4 × 4.8 × 3.7	<b>SOT23</b> (3 引脚) 2.9 × 2.4 × 1.1 <b>TO92</b> (3 引脚) 7.4 × 4.8 × 3.7	<b>SC70</b> (5 引脚) 2.0 × 2.1 × 1.1 <b>DSBGA</b> (4 引脚) 0.96 × 0.96 × 0.6	<b>SOIC</b> (8 引脚) 4.9 × 6.0 × 1.75 <b>TO92</b> (3 引脚) 7.4 × 4.8 × 3.7 <b>TOCAN</b> (3 引脚) 4.7 × 4.7 × 2.67 <b>TO220</b> (3 引脚) 15 × 10 × 4.6

1. LMT90、LM50C、LM50B、LM60、LM61B 和 LM35 温度精度限制来自“精度与温度间的关系”图。

表 4-2. LMT90 器件可订购选项

订货编号	封装	在温度范围内的精度	额定温度范围
LMT90DBZR	SOT-23 (DBZ) 3 引脚	$\pm 4^{\circ}\text{C}$	$-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$

表 4-3. LMT90 器件命名规则详细信息

产品	说明
LMT90yyyR	该器件可以随附旧芯片 (CSO : GF6 或 SHE) 或新芯片 (CSO : RFB), 其具有不同芯片源产地 (CSO)。卷带封装标签提供日期代码信息以区分正在使用的芯片。在整个文档中对新芯片和旧芯片的器件性能进行了说明。 yyy 表示此器件的封装类型, 即采用 SOT-23 3 引脚封装的 DBZ。

## 5 引脚配置和功能

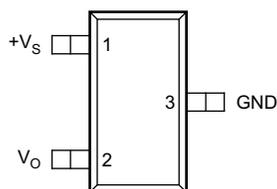


图 5-1. DBZ 封装 3 引脚 SOT-23 顶视图

表 5-1. 引脚功能

引脚		类型	说明
编号	名称		
1	+V <sub>S</sub>	电源	正极电源引脚。
2	V <sub>O</sub>	输出	温度传感器模拟输出。
3	GND	接地	器件接地引脚, 连接到电源负极端。

## 6 规格

### 6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) <sup>(1)</sup>

		最小值	最大值	单位
电源电压, +V <sub>S</sub>	LMT90	-0.2	12	V
输出电压, V <sub>O</sub>		-1	+V <sub>S</sub> + 0.6	V
输出电流, I <sub>OUT</sub>			10	mA
最大结温, T <sub>JMAX</sub>			150	°C
贮存温度, T <sub>stg</sub>		-65	150	°C

(1) 在绝对最大额定值范围外运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件能够在该等条件下或在任何超出建议运行条件的其他条件下正常运行。如果在建议运行条件以外,但在绝对最大额定值范围以内使用,器件可能无法完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能与性能,并且可能缩短器件寿命。

### 6.2 ESD 等级

		值	单位
V <sub>(ESD)</sub> , 静电放电	LMT90	人体放电模型 (HBM), 符合 JESD22-A114 标准 <sup>(1)</sup>	±2000
		充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101	±750

(1) 人体放电模型是一个通过 1.5kΩ 电阻器对每个引脚放电的 100pF 电容器。机器模型是一个直接对每个引脚放电的 200pF 电容器。

### 6.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

		最小值	最大值	单位
+V <sub>S</sub>	电源电压	4.5	10	V
T <sub>MIN</sub> , T <sub>MAX</sub>	额定温度	-40	125	°C

### 6.4 热性能信息

热指标 <sup>(1)</sup>		LMT90		单位
		DBZ (SOT-23) 3 引脚		
		旧芯片	新芯片	
R <sub>θJA</sub>	结至环境热阻	450	240.6	°C/W
R <sub>θJC(top)</sub>	结至外壳 (顶部) 热阻	-	144.5	°C/W
R <sub>θJB</sub>	结至电路板热阻	-	72.3	°C/W
ψ <sub>JT</sub>	结至顶部特征参数	-	28.7	°C/W
ψ <sub>JB</sub>	结至电路板特征参数	-	71.7	°C/W
R <sub>θJC(bot)</sub>	结至外壳 (底部) 热阻	-	-	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息,请参阅[半导体和 IC 封装热指标应用手册](#)。

## 6.5 电气特性

这些规格适用于  $+V_S = 5V$  (直流) 且  $I_{LOAD} = 0.5\mu A$ 、 $T_A = T_J = 25^\circ C$  (除非另有说明) <sup>(1)</sup>

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
<b>传感器精度</b>							
$T_{ACY}$	温度精度 <sup>(2)</sup>	$T_A = 25^\circ C$	LMT90	-3		3	$^\circ C$
		$T_A = T_{MAX} = 125^\circ C$		-4		4	
		$T_A = T_{MIN} = -40^\circ C$		-4		4	
<b>传感器输出</b>							
$V_{0^\circ C}$	$0^\circ C$ 时的输出失调电压				500		mV
$T_C$	温度系数 (传感器增益)	$T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 $T_{MAX}$		9.7	10	10.3	mV/ $^\circ C$
$V_{ONL}$	输出非线性 <sup>(3)</sup>	$T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 $T_{MAX}$		-0.8		0.8	$^\circ C$
$Z_{OUT}$	输出阻抗	$T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 $T_{MAX}$			2000	4000	$\Omega$
$T_{ON}$	开通时间		旧芯片		5		$\mu s$
			新芯片		30		
$T_{LTD}$	长期稳定性和漂移 <sup>(4)</sup>	$T_J = 125^\circ C$ , 1000 小时			$\pm 0.08$		$^\circ C$
<b>电源</b>							
$I_{DD}$	工作电流	$4.5V \leq +V_S \leq 10V$	旧芯片			130	$\mu A$
			新芯片			75	
		$T_A = T_{MIN}$ 至 $T_{MAX}$ $4.5V \leq +V_S \leq 10V$	旧芯片		95	180	$\mu A$
			新芯片		52	90	
$PSR$	线性调整率 <sup>(5)</sup>	$T_A = T_{MIN}$ 至 $T_{MAX}$ $4.5V \leq +V_S \leq 10V$		-1.2		1.2	mV/V
$\Delta I_{DD}$	静态电流的变化量	$T_A = T_{MIN}$ 至 $T_{MAX}$ $4.5V \leq +V_S \leq 10V$	旧芯片			2	$\mu A$
			新芯片			8	
$I_{DD\_TEMP}$	静态电流的温度系数	$T_A = T_{MIN}$ 至 $T_{MAX}$ $4.5V \leq +V_S \leq 10V$			2		$\mu A/^\circ C$

- 限值特定于 TI 的 AOQL (平均出厂质量水平)。
- 精度定义为在指定的电压、电流和温度条件下, 输出电压与  $10mV/^\circ C$  乘以器件外壳温度加  $500mV$  之间的误差 (以  $^\circ C$  表示)。
- 非线性被定义为输出电压和温度的关系曲线在器件的额定温度范围内与最佳拟合直线的偏差。
- 为了获得最佳的长期稳定性, 任何精密电路在开始长期寿命测试之前, 如果器件在较高温度下老化, 和/或温度循环至少 46 小时, 将能提供最佳效果。当小型 (表面贴装) 器件进行波焊时尤其如此; 留出时间让应力放松。大多数漂移发生在高温下的前 1000 小时内。1000 小时后的漂移不会以第一个 1000 小时的速率持续。
- 调整率是在恒定结温下使用低占空比脉冲测试进行测量的。由热效应引起的输出变化可以通过内部耗散乘以热阻来计算。

## 6.6 典型特性

为了生成这些曲线，将器件安装在印刷电路板上，如图 8-9 或图 8-10 所示。

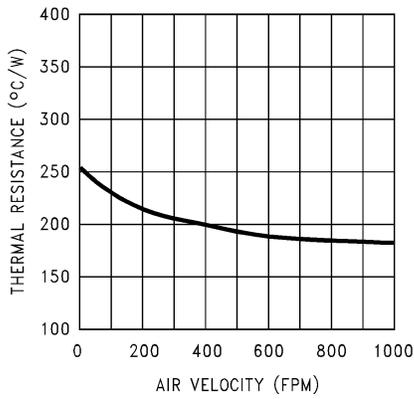


图 6-1. 热阻结温至环境温度 (旧芯片)

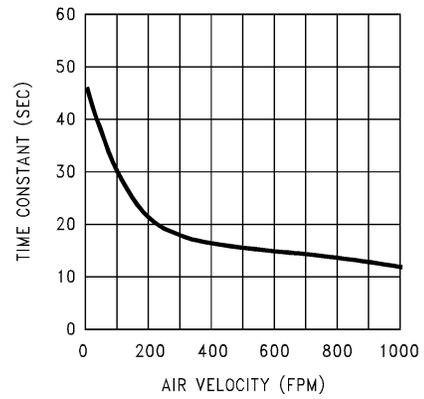


图 6-2. 热时间常数 (旧芯片)

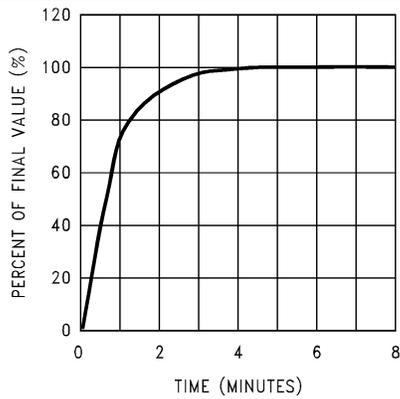


图 6-3. 带散热器时静止空气中的热响应 (旧芯片)

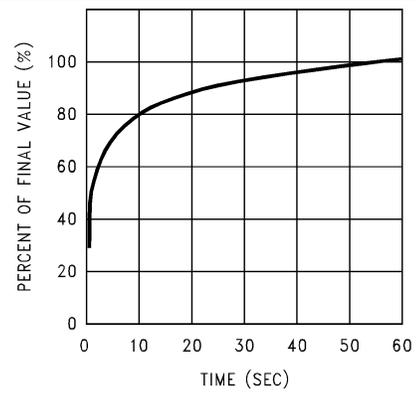


图 6-4. 带散热器时搅拌油浴中的热响应 (旧芯片)

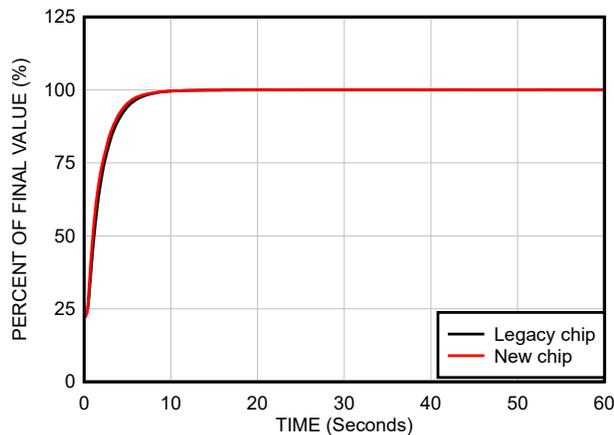


图 6-5. 带散热器时搅拌油浴中的热响应 (0.5 英寸× 0.5 英寸 PCB 板)

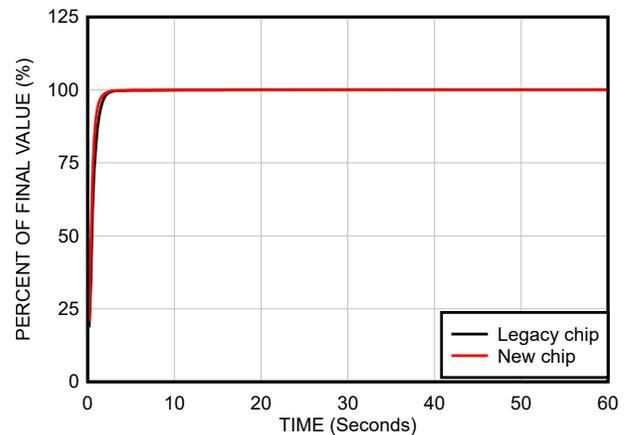


图 6-6. 不带散热器时搅拌油浴中的热响应

### 6.6 典型特性 (续)

为了生成这些曲线, 将器件安装在印刷电路板上, 如图 8-9 或图 8-10 所示。

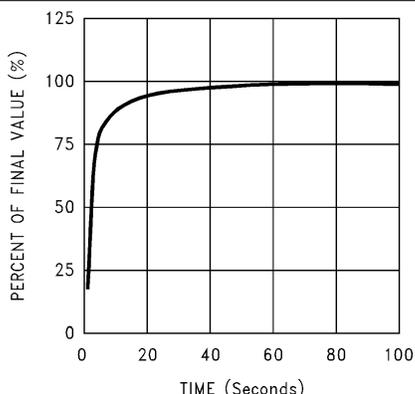


图 6-7. 不带散热器时静止空气中的热响应 (旧芯片)

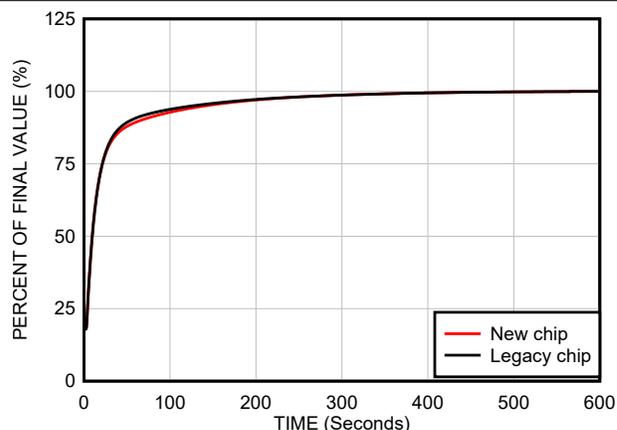


图 6-8. 不带散热器时静止空气中的热响应 (新测试设置中既有旧芯片也有新芯片)

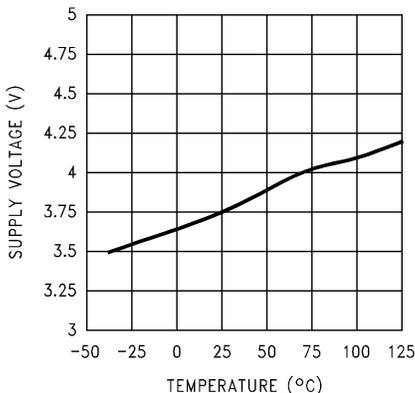


图 6-9. 启动电压与温度之间的关系 (旧芯片)

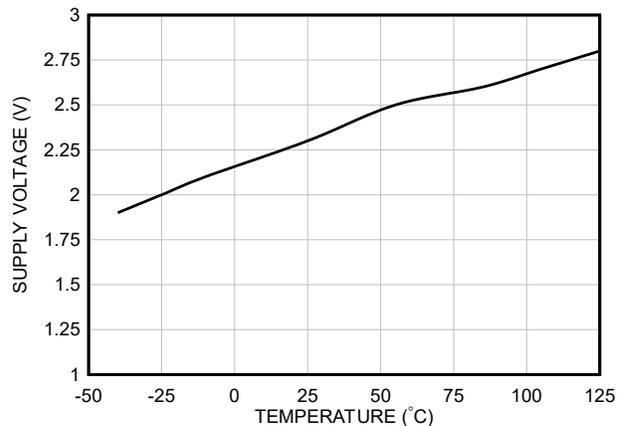


图 6-10. 启动电压与温度之间的关系 (新芯片)

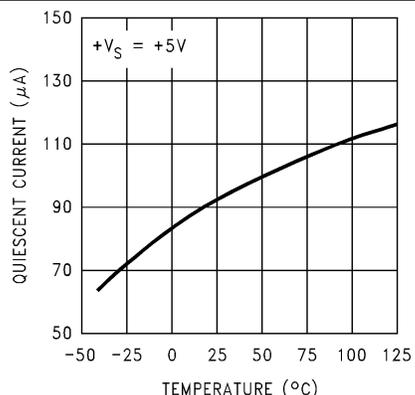


图 6-11. 静态电流与温度之间的关系 (旧芯片)

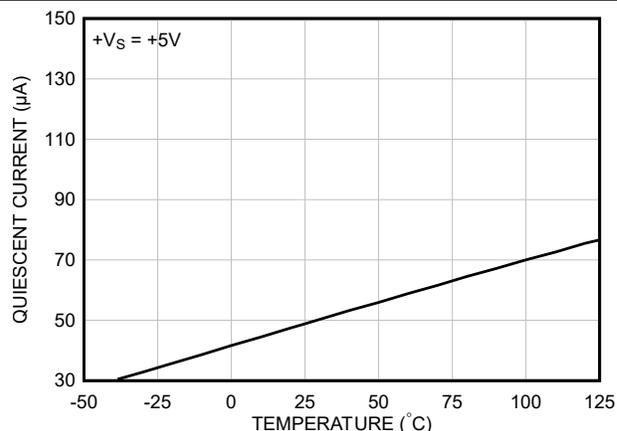


图 6-12. 静态电流与温度之间的关系 (新芯片)

## 6.6 典型特性 (续)

为了生成这些曲线, 将器件安装在印刷电路板上, 如图 8-9 或图 8-10 所示。

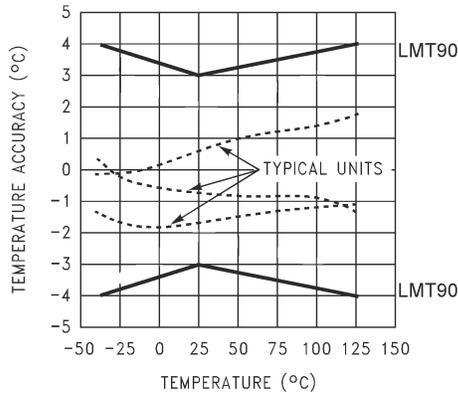


图 6-13. 精度与温度之间的关系 (旧芯片)

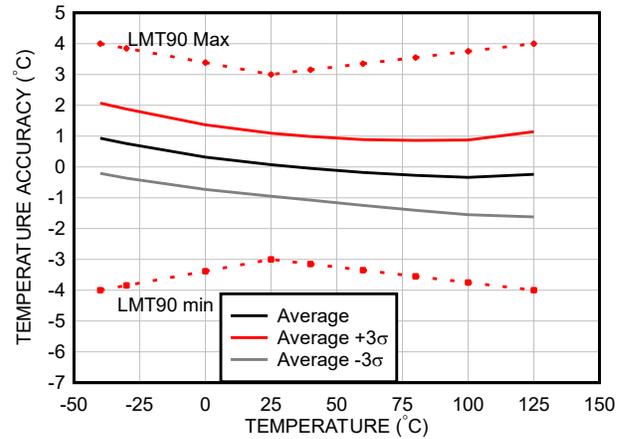


图 6-14. 精度与温度之间的关系 (新芯片)

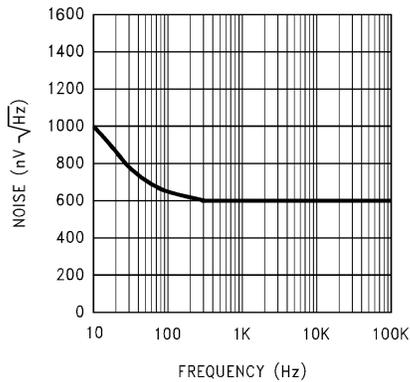


图 6-15. 噪声电压 (旧芯片)

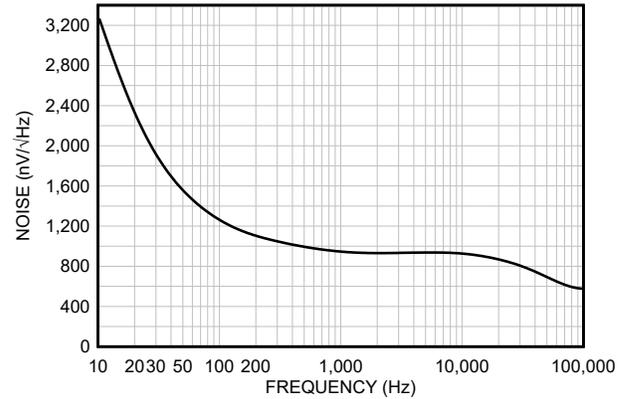


图 6-16. 噪声电压 (新芯片)

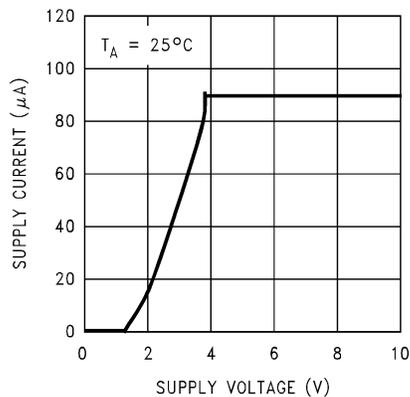


图 6-17. 电源电流与电源电压之间的关系 (旧芯片)

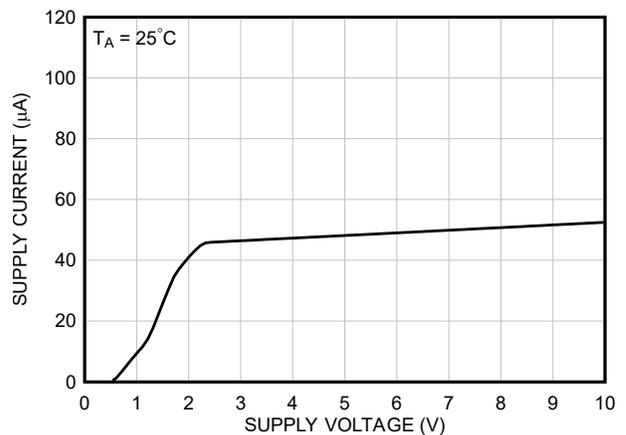


图 6-18. 电源电流与电源电压之间的关系 (新芯片)

## 6.6 典型特性 (续)

为了生成这些曲线，将器件安装在印刷电路板上，如图 8-9 或图 8-10 所示。

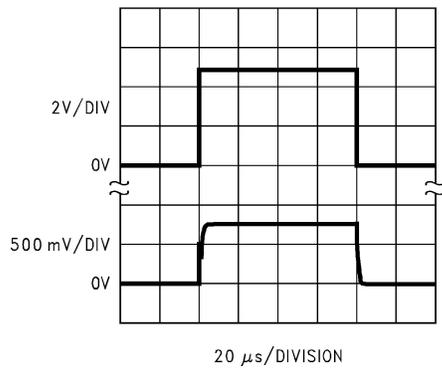


图 6-19. 启动响应 (旧芯片)

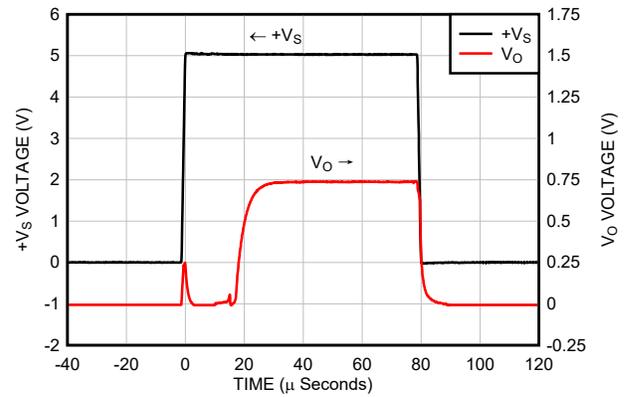


图 6-20. 启动响应 (新芯片)

## 7 详细说明

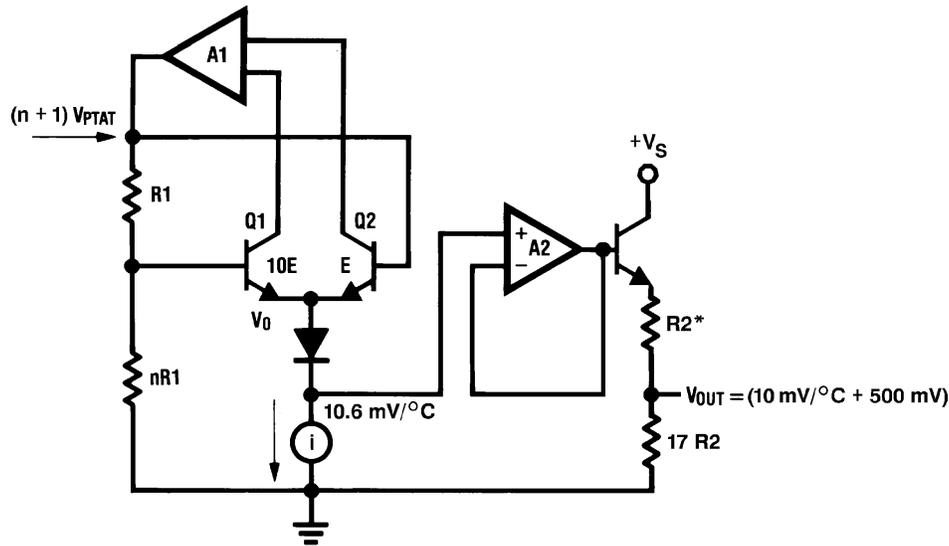
### 7.1 概述

LMT90 器件是一种精密集成电路温度传感器，可使用单个正电源检测  $-40^{\circ}\text{C}$  至  $125^{\circ}\text{C}$  的温度范围。LMT90 的输出电压具有  $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$  的正温度斜率。包含  $500\text{mV}$  的失调电压，可在单电源偏置时实现负温度检测。

温度检测元件由  $\Delta-V_{\text{BE}}$  架构组成。温度检测元件通过放大器进行缓冲，并连接至  $V_{\text{O}}$  引脚。放大器有一个简单的 A 类输出级，该输出级具有典型的  $2\text{k}\Omega$  输出阻抗，如 [功能方框图](#) 所示。输出阻抗具有大约  $1300\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$  的温度系数。过温时输出阻抗将在  $4\text{k}\Omega$  时达到最大值。

### 7.2 功能方框图

\* $R2 \cong 2\text{k}$ ，典型漂移为  $1300\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 。



### 7.3 特性说明

#### 7.3.1 LMT90 传递函数

LMT90 遵循简单的线性传递函数，以实现 [节 6.5](#) 表中所列的精度。

使用 [方程式 1](#) 计算  $V_{\text{O}}$  的值。

$$V_{\text{O}} = 10\text{mV}/^{\circ}\text{C} \times T^{\circ}\text{C} + 500\text{mV} \quad (1)$$

其中

- $T$  是以  $^{\circ}\text{C}$  为单位的温度
- $V_{\text{O}}$  为 LMT90 输出电压

### 7.4 器件功能模式

该器件的唯一功能模式是与温度成正比的模拟输出。

## 8 应用和实施

### 备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

### 8.1 应用信息

LMT90 具有宽电源电压范围和  $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$  的输出斜率以及  $500\text{mV}$  直流失调电压。因此，该器件可轻松放置在许多温度检测应用中，在这些应用中，正负温度需要单电源。

### 8.2 典型应用

#### 8.2.1 全量程摄氏温度传感器

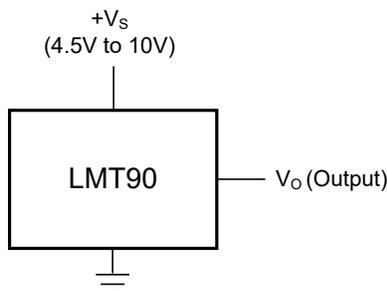


图 8-1. 全量程摄氏温度传感器图 (  $-40^{\circ}\text{C}$  至  $125^{\circ}\text{C}$  )

#### 8.2.1.1 设计要求

本设计示例使用表 8-1 中所列的参数作为输入参数。

表 8-1. 设计参数

参数	值
电源电压	4.5V 至 10V
输出阻抗	$4\text{k}\Omega$ (最大值)
$25^{\circ}\text{C}$ 时的精度	$\pm 3^{\circ}\text{C}$ (最大值)
超过 $-40^{\circ}\text{C}$ 至 $125^{\circ}\text{C}$ 时的精度	$\pm 4^{\circ}\text{C}$ (最大值)
温度斜率	$10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

#### 8.2.1.2 详细设计过程

LMT90 是一款提供模拟输出的简单温度传感器。因此，与布局相关的设计要求比其他要求更重要。有关更多信息，请参阅 [布局](#)。

##### 8.2.1.2.1 容性负载

LMT90 能够可靠处理电容负载。如果没有任何特殊预防措施，LMT90 可以驱动任电容负载。该器件具有标称  $2\text{k}\Omega$  输出阻抗 (如 [功能方框图](#) 所示)。输出电阻器的温度系数约为  $1300\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 。考虑到该温度系数和电阻器的初始容差，器件的输出阻抗不会超过  $4\text{k}\Omega$ 。在噪声极大的环境中，可能需要添加滤波以更大限度地减少噪声拾取。TI 建议在  $+V_S$  到 GND 之间添加  $0.1\ \mu\text{F}$  电容器以绕过电源电压，如图 8-3 所示。可能需要在  $V_O$  和接地端之间添加一个电容器。具有  $4\text{k}\Omega$  输出阻抗的  $1\ \mu\text{F}$  输出电容器形成一个  $40\text{Hz}$  的低通滤波器。由于 LMT90 的热时间常数比 RC 形成的  $25\text{ms}$  时间常数慢得多，因此器件的整体响应时间不会受到显著影响。对于更大的电容器，这种额外的时间滞后会增加 LMT90 的总体响应时间。

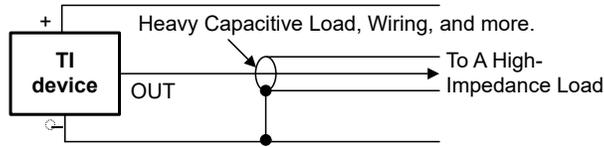


图 8-2. LMT90 电容负载无需去耦

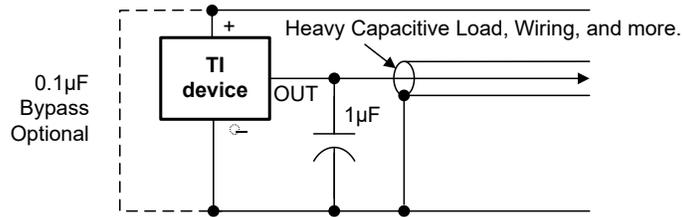


图 8-3. 适用于嘈杂环境且具有滤波器的 LMT90

8.2.1.3 应用曲线

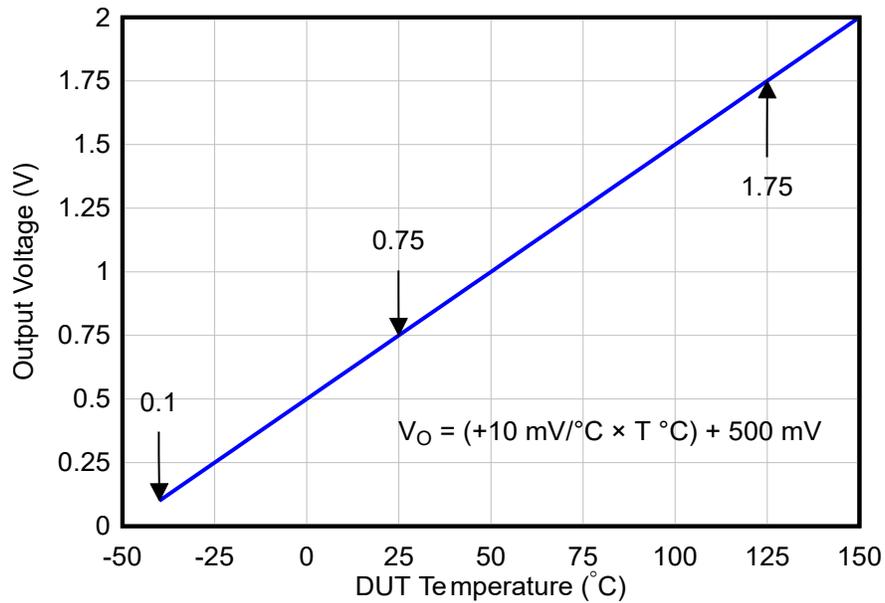


图 8-4. 输出传递函数

### 8.3 系统示例

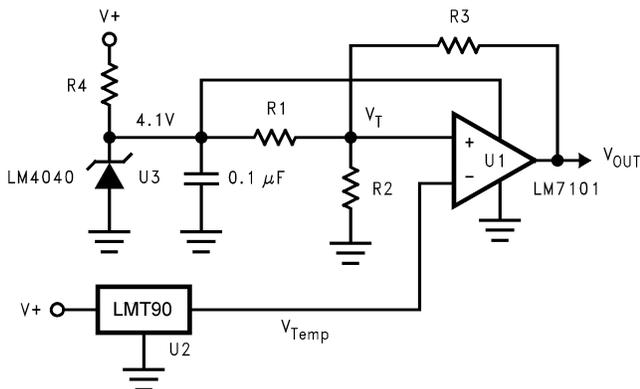


图 8-5. 摄氏温度恒温器/风扇控制器

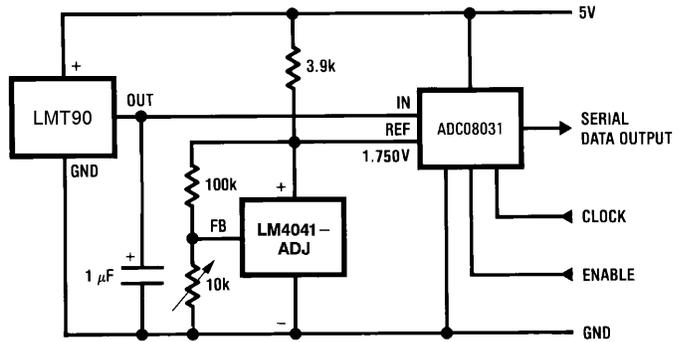


图 8-6. 温度数字转换器 (串行输出) (125°C 满量程)

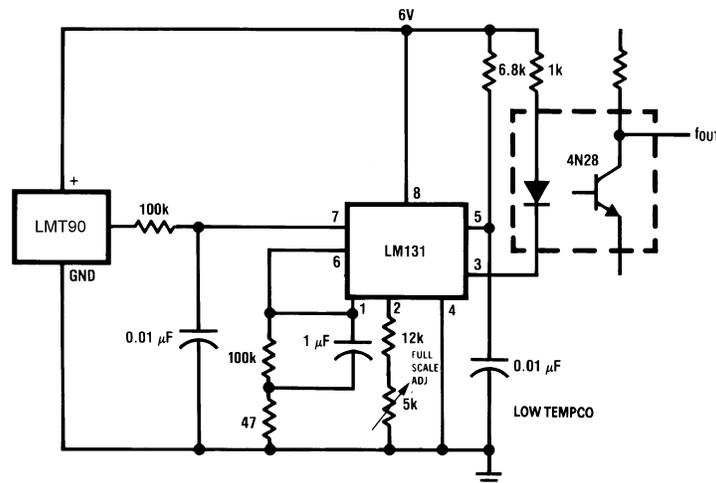


图 8-7. 具有电压频率转换器和隔离式输出的 LMT90 (-40°C 至 125°C ; 100Hz 至 1750Hz)

### 8.4 电源相关建议

在噪声极大的环境中，可能需要添加一些滤波来更最大限度地减少噪声拾取。TI 建议在 +V<sub>S</sub> 到 GND 之间添加 0.1μF 电容器以绕过电源电压，如图 8-3 所示。

### 8.5 布局

#### 8.5.1 布局指南

LMT90 可像其他集成电路温度传感器一样轻松应用。器件可用胶或水泥粘在表面上，温度处于表面温度的 0.2°C 左右范围内。

这是假定环境空气温度与该表面温度大致相同的情况；如果空气温度远高于或低于表面温度，则 LMT90 芯片的实际温度为表面温度与空气温度之间的中间温度。

为提供良好的导热性，LMT90 芯片的背面直接与 GND 引脚相连。器件的焊盘和走线是印刷电路板的一部分，而印刷电路板是温度测量的对象。这些印刷电路板焊盘和走线不会导致 LMT90 温度偏离所需温度。

或者，可将 LMT90 安装在两端密封的金属管内，然后浸入水槽或拧入水箱的螺纹孔中。与任何器件相同，LMT90 及随附接线和电路必须保持处于绝缘和干燥状态，以免漏电和腐蚀。如果电路在可能发生冷凝的低温条件下运行，则尤其如此。通常使用印刷电路涂层和清漆（例如 HUMISEAL® 和环氧树脂油漆或浸漆）来确保湿气不会腐蚀器件或其连接。

### 8.5.2 布局示例

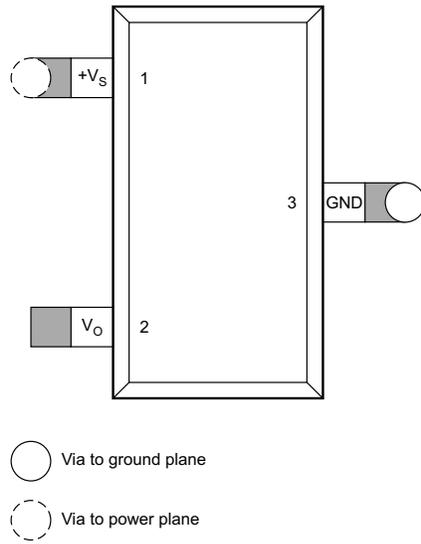
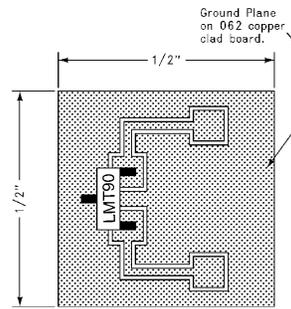


图 8-8. PCB 布局



带有 2 盎司铜箔片或类似材料的 1/2 英寸方形印刷电路板

图 8-9. 用于散热器生成热响应曲线的印刷电路板 (旧芯片)

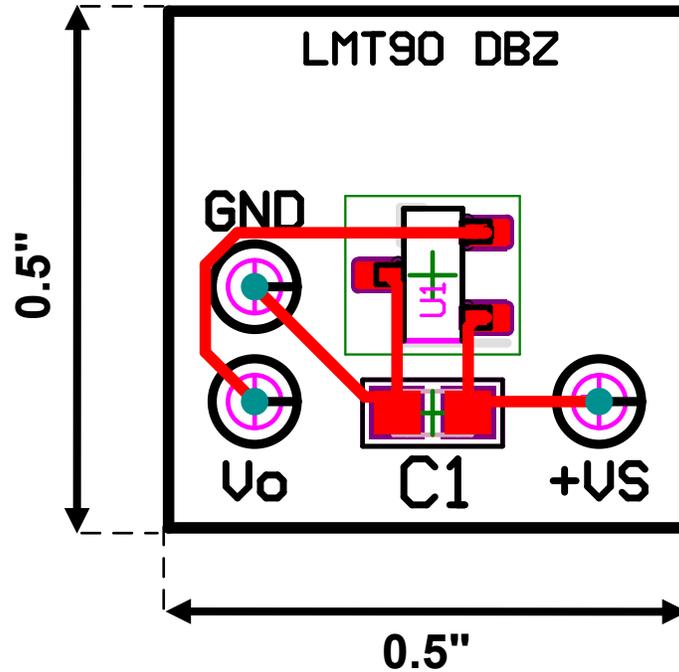


图 8-10. 用于生成热响应曲线的印刷电路板 (新芯片和旧芯片的新测试设置)

### 8.5.3 散热注意事项

表 8-2 总结了 LMT90 在不同条件下的热阻。

表 8-2. LMT90 由于自发热而导致的温升

			$R_{\theta JA}$ (°C/W)
SOT-23	无散热器 <sup>(1)</sup>	静止空气 (旧芯片)	450
		流动空气 (旧芯片)	-
	小型散热器 <sup>(2)</sup>	静止空气 (旧芯片)	260
		流动空气 (旧芯片)	180

(1) 器件焊接到 30 号导线。

(2) 使用的散热器是带有 2 盎司箔片的 0.5 英寸方形印刷电路板；其部件安装如图 8-9 所示。

## 9 器件和文档支持

### 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI), [LM50 SOT-23 单电源摄氏温度传感器](#) 数据表
- 德州仪器 (TI), [TMP23x 低功耗高精度模拟输出温度传感器](#), 数据表
- 德州仪器 (TI), [ISOTMP35 具有模拟输出、小于 2 秒响应时间和 500VRMS 工作电压的  \$\pm 1.2^{\circ}\text{C}\$ 、3-kVRMS 隔离温度传感器](#), 数据表
- 德州仪器 (TI), [LM60 2.7V、SOT-23 或 TO-92 温度传感器](#), 数据表
- 德州仪器 (TI), [用于远程系统的微型温度传感器](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI), [半导体温度传感器挑战楼宇自动化中的精密 RTD 和热敏电阻](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI), [LMT90 温度传感器评估模块 EVM](#)

### 9.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](http://ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

### 9.2 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

### 9.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

HUMISEAL® is a registered trademark of Columbia Chase Corporation.

所有商标均为其各自所有者的财产。

### 9.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

### 9.5 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision B (September 2015) to Revision C (May 2025)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图片以及交叉参考的编号格式.....	1
• 更新了文档以反映最新系列格式和标准.....	1
• 在整个文档中添加了新器件的规格和图形，并将该器件与旧器件进行了比较.....	1
• 添加了 <a href="#">器件比较</a> 、 <a href="#">可订购器件选项</a> 和 <a href="#">命名规则详细信息</a> 表.....	3
• 删除了机器模型 (MM) 静电放电。.....	5
• 为新芯片添加了 DBZ 封装“热性能信息”.....	5
• 为旧芯片和新芯片添加了“导通时间”。.....	6

- 为新芯片添加了“工作电流”和“静态电流的变化”。..... 6
- 

**Changes from Revision A (March 2013) to Revision B (September 2015)****Page**

- 添加了“引脚配置和功能”部分、ESD 等级表、“特性说明”部分、器件功能模式、“应用和实施”部分、“电源相关建议”部分、“布局”部分、“器件和文档支持”部分以及“机械、封装和可订购信息”部分..... 1
- 

## 11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">LMT90DBZR</a>	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU   SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T8C
LMT90DBZR.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T8C
LMT90DBZR.B	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T8C
<a href="#">LMT90DBZT</a>	Obsolete	Production	SOT-23 (DBZ)   3	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	T8C

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LMT90DBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	2.9	3.35	1.35	4.0	8.0	Q3
LMT90DBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LMT90DBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LMT90DBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0

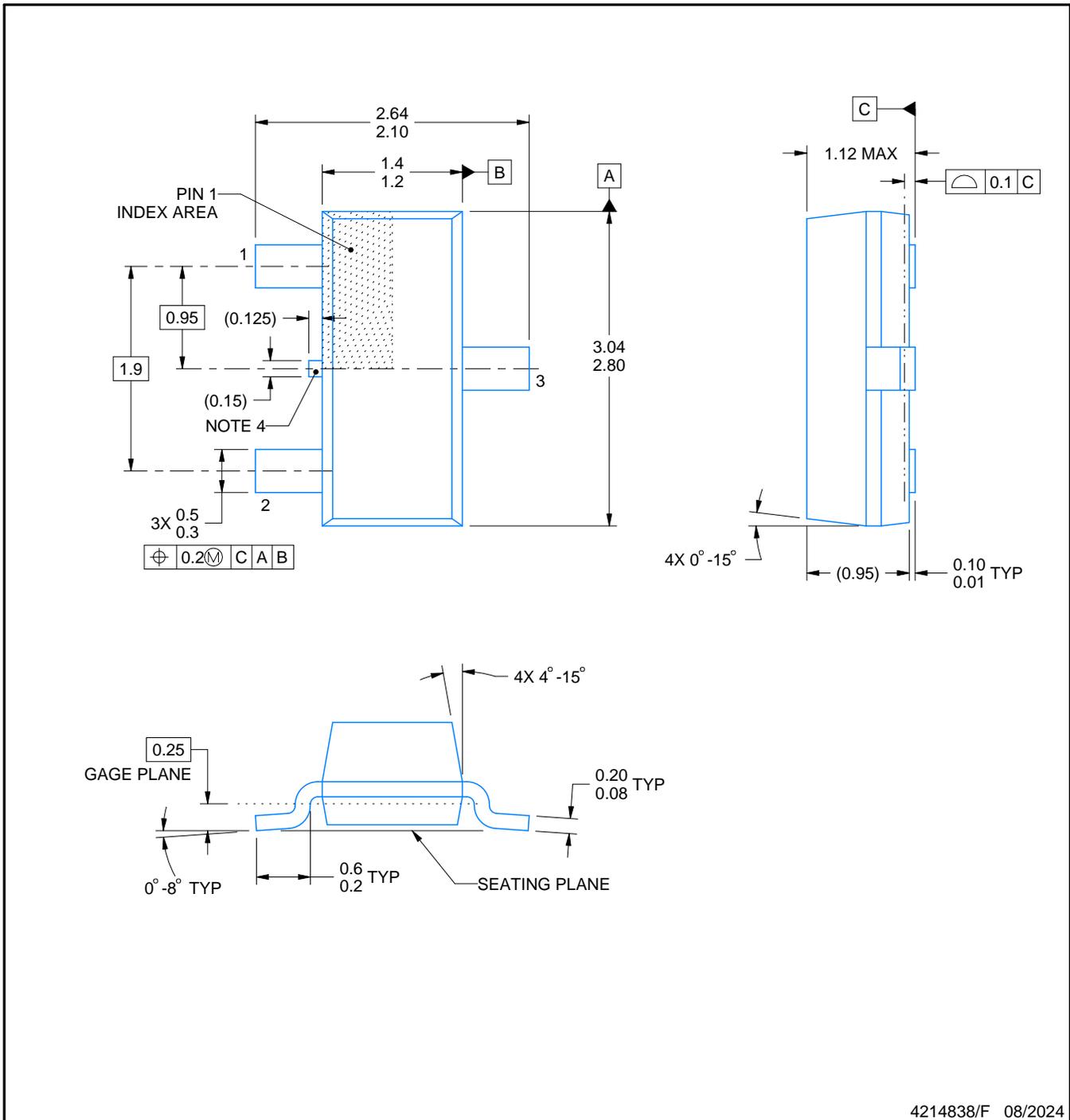
# DBZ0003A



# PACKAGE OUTLINE

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



4214838/F 08/2024

**NOTES:**

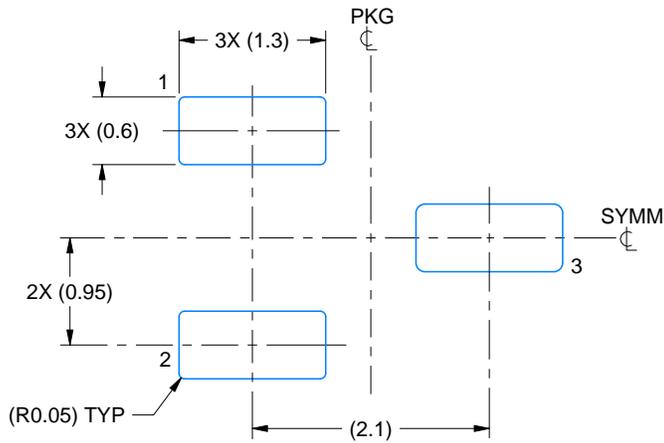
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration TO-236, except minimum foot length.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

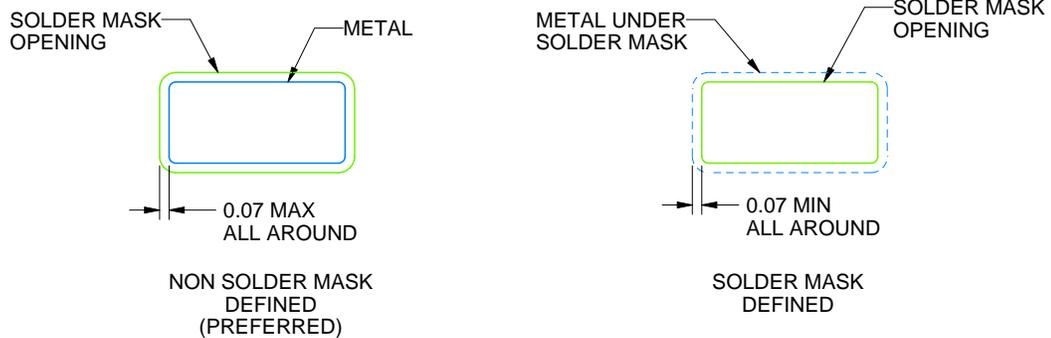
DBZ0003A

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214838/F 08/2024

NOTES: (continued)

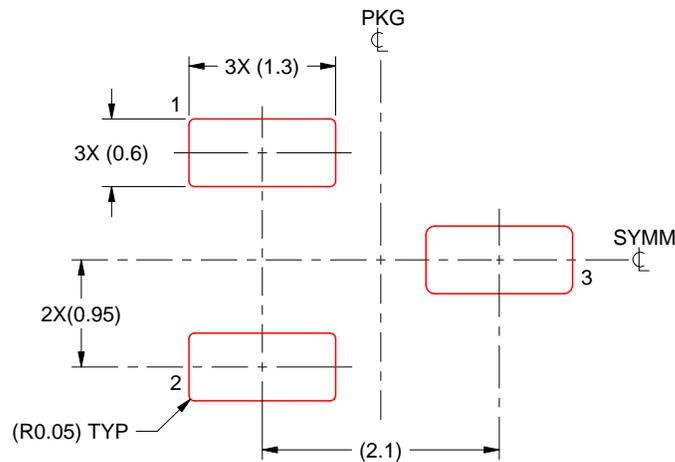
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBZ0003A

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 THICK STENCIL  
SCALE:15X

4214838/F 08/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月